

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

湖北鼎龙控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20230706

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称 及人员姓名	2023年7月5日：华夏基金：张景松、张皓智、彭锐哲；高毅资产：赵浩；南方基金：陈思臻；德邦资管：陈祥辉；宏道投资：段然；展博投资：黄嘉杰；启铼基金：王远洋；淳厚基金：赵绮晖；中泰证券：李硕文；天风证券：吴雨；国元证券：郝润祺；安信证券：姜媞媞；华鑫证券：吕卓阳；西部证券：王凌涛等 17 名投资者及证券人员 2023年7月6日：财通基金：沈犁；中欧基金：郭睿；博时基金：李重阳
时间	2023年7月5日下午 13:00-15:00 2023年7月6日上午 10:00-12:00
地点	公司 905 会议室
上市公司接待 人员姓名	投资者关系经理朱梦茜女士
投资者 关系活动 主要内容 介绍	<p>上市公司接待人员介绍公司基本情况，并与投资者就公司半导体材料业务、打印复印通用耗材业务的经营及其他投资者关心的问题进行深入交流，主要交流内容如下：</p> <p>问 1：公司近年来新项目布局和成果转化的速度在加快，原因有哪些？ 答：公司作为进口替代类创新材料的平台型企业，为抓住半导体及新型显示行业布局的黄金窗口期，并实现细分材料领域的国产领先优势，近几年一直保持较快的布局速度，且新项目从立项到实现销售的推进速度也明显加快。公司新项目快速推进的主要原因有：</p> <p>1、技术平台的整合和运用：公司重视技术整合，二十多年来利用技术积累和人才稳定打造了七大技术平台，将材料开发的共性技术运用到新项目的研发过程中，如将彩色碳粉中的高分子合成技术运用到 CMP 抛光垫和聚酰亚胺 PI 材料的研发过程中、将彩色碳粉中的物理化学技术运用到 CMP 抛光液及清洗液的研发过程中、将载体中的无机非金属技术运用到研磨粒子的研发过程中等，这能加快公司新产品开发速度。</p> <p>2、自主评价体系完善：公司坚持材料技术创新与用户验证工艺发展同步，建立了 CMP 工艺评价验证体系、显示材料评价验证体系和半导体先进封装领域的键合/解键合工艺及封装光刻工艺等应用评价平台，通过进行半</p>

导体制程 CMP 抛光环节、显示面板制造涂布环节、键合/解键合环节等下游用户实际工艺流程，对相关材料产品进行应用验证，有助于加深产品理解并缩短产品开发周期。

3、客情关系良好：随着公司 CMP 抛光垫产品在下游核心晶圆厂客户的稳定规模化使用，以及半导体显示材料 YPI、PSPI 产品在主流面板厂的逐步放量，公司与下游客户建立起了信任和良好的合作关系，这对公司其他半导体材料的定制化开发和验证导入提供了帮助，加快公司新产品的验证速度。

问 2：公司在供应链管理方面的布局如何？

答：公司坚持材料技术创新与上游原材料自主化培养同步，通过自主研发和投资、培育国内上游原材料厂商的形式，提升公司产品上游供应链的自主化程度，这对产品生产的安全稳定、自主可控有较大帮助，同时也有助于加深材料产品理解和从原料入手进行定制化开发。此外，在打印复印通用耗材板块，公司布局了耗材成品上游核心原材料—彩色聚合碳粉、耗材芯片和显影辊等，这对公司耗材成品的协同支持、产业信息传递等提供了帮助，提升了公司耗材业务的竞争力。

问 3：公司 CMP 抛光垫业务进展情况如何？

答：公司是国内唯一一家全面掌握抛光垫全流程核心研发和制造技术的 CMP 抛光垫国产供应商，深度渗透国内主流晶圆厂供应链，产品质量获得客户高度肯定。今年上半年，公司把市场开拓重心放在了主要逻辑客户上，逻辑客户的销售占比在逐步提升，客户结构得到优化。此外，公司潜江三期抛光垫新品产线的投产运行，使公司 CMP 抛光垫产品布局进一步完善，这也给抛光垫产品的市场推广提供了帮助。

问 4：公司 CMP 抛光液业务的进展情况如何？

答：总体来看，公司 CMP 抛光液业务今年处于快速放量阶段，目前公司已有的数款 CMP 抛光液产品在客户端规模化销售，其他各制程 CMP 抛光液产品覆盖全国多家客户进入关键验证阶段。公司 CMP 抛光液产品有多个优势：（1）在供应链方面，公司实现了 CMP 抛光液核心原材料研磨粒子的自主制备，研磨粒子对抛光液产品品质有较大影响，同时在抛光液的材料成本中占比较高。研磨粒子自主供应有助于公司对 CMP 抛光液产品进行定制化开发，增强公司抛光液产品供应链的安全、稳定、经济性。（2）在平台化布局方面，公司作为创新材料的平台型企业，布局了集成电路制造 CMP 抛光环节的多款核心耗材，提供 CMP 制程工艺材料系统化解决方案，这加深了公司对 CMP 抛光液产品应用的理解以及 CMP 抛光液、抛光垫等材料适配使用的理解，从而增强了公司抛光液产品的竞争力。

问 5：公司半导体先进封装材料业务的进展情况如何？

答：半导体先进封装技术是国内晶圆厂制程工艺技术进步的重要途径，先进封装材料在国内的市场空间处于上升阶段。公司选取了国内尚未实现自主化替代、技术门槛高、同时与公司已有技术积累存在共性的几款先进封装材料进行布局，目前各产品都在按计划进行导入、验证和产品开发工作。此外，随着键合/解键合平台、封装光刻机、可靠性评价及其配套设备等应用

	<p>评价平台的建设完成及投入使用，公司半导体先进封装材料项目的推进速度也将进一步加快。</p> <p>问 6：公司打印复印通用耗材业务情况如何？</p> <p>答：公司在保障传统业务—打印复印通用耗材业务的整体竞争力和业绩贡献的同时，持续推进打印耗材业务的效率提升和转型升级。上游彩色碳粉、耗材芯片产品继续保持对终端硒鼓、墨盒成品的业务协同、支持力度，同时芯片业务从打印复印耗材芯片向工业级和车规级应用的安全芯片等新产品方向进行深度转型；终端硒鼓业务进行深度整合，硒鼓自动化产线逐渐稳定量产，降本控费、效率提升等工作取得阶段性成效；终端墨盒业务拟挂牌新三板，积极拓展线上客户及市场渠道，进一步提升公司墨盒业务的核心竞争力。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 7 月 6 日